

FY26 3Q　決算説明資料

リガク・ホールディングス株式会社

2026年11月11日

注意事項

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2023年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しております。

本資料には、研究開発費比率、設備投資額比率、フリーキャッシュ・フローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義および算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益および営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

なお、本資料における金額表記は億円未満を切り捨てて表示し、比率の数値は小数第2位を四捨五入して表示しています。

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

アジェンダ

1．FY26 3Q 連結決算概要

2．半導体プロセス・コントロール機器事業アップデート

3．FY26 業績見通し

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q 連結決算概要

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q 連結決算ハイライト

全社

- 3Q：受注好調が続きYoY 66%の成長、売上収益YoY 13%成長。
- 3Q累計：受注はYoY 39%の成長、売上収益YoY 2%成長。パイプラインも前年同期比 21%増加
- 3Qに特殊要因として13.6億円を損失計上したが、営業利益率は2.9pt改善（特殊要因除く営業利益率は9.3pt改善）
- 4Qのボリューム増/値上げ/新製品効果を確実に取り込み利益率のさらなる改善を目指す

多目的分析機器

- 3Q：受注YoY 39%の大幅伸長、中国除く全地域でYoY 2ケタ増で回復鮮明化。売上収益YoY 4%成長。営業利益率は4.3pt改善
- 3Q累計：受注YoY 16%成長、全地域でプラス、特に日本で26%、米州で32%の伸長
- 好調な受注を今後の売上収益回復につなげる

半導体プロセス・コントロール機器

- 3Q：受注はYoY 189%増で足元受注予測も引き続き非常に強い。売上収益YoY 29%成長
- 3Q累計：受注はYoY 117%成長、売上収益YoY 21%成長。共に計画を上回り進捗
- メモリ増産需要と北米IDM需要回復に加えてJEPを含む新製品が貢献、4Q売上収益は昨年を上回る過去最高の水準を目指す

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q 連結業績サマリー（YoY）

(億円)	2025 3Q	2026 3Q	前年同期比
売上収益	187	**211**	+12.7%
売上総利益	97	**124**	+27.4%
営業利益	8	**15**	+84.2%
営業利益率(%)	4.5%	**7.4%**	+2.9pt
税引前利益	6	**12**	+94.8%
四半期利益(1)	4	**8**	+72.0%
基本的EPS(円)	2.18	**3.76**	-
EBITDA	21	**37**	+71.8%
EBITDA率(%)	11.7%	**17.8%**	+6.1pt

- 受注はYoY 66%の増加
- 売上収益は全カテゴリーで増収
- 売上総利益率は各カテゴリーで改善、連結ベースで YoY 6.8pt改善
- 営業利益も増益
- 特殊要因として、米国にて貸倒引当金6億円、欧州子会社（MILabs）の減損7.5億円を計上
- 戦略投資額はほぼ計画通りで推移しており、年間を通じて予定通りの売上収益に達することで、戦略投資の利益率への影響は年初計画通りほぼフラット。4Q売上総利益率の改善を見込む

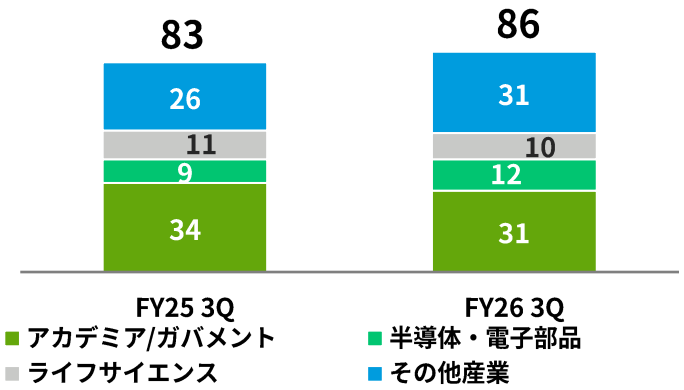
注:
1. 親会社の所有者に帰属する四半期利益に読み替え

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q カテゴリー別業績サマリー

多目的分析機器

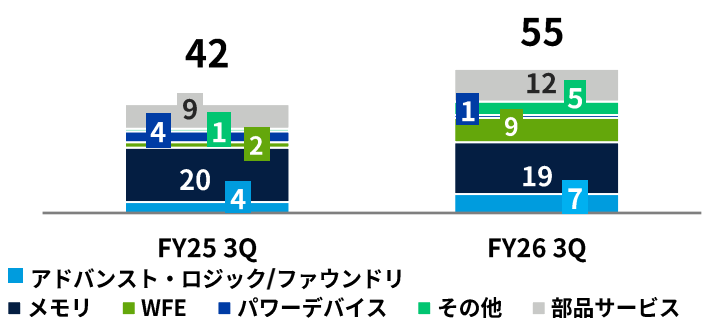
(億円)	FY25 3Q	FY26 3Q	YoY
売上収益	83	**86**	+4.4%
営業利益	4	**8**	+87.2%
営業利益率 (%)	5.4%	**9.7%**	+4.3pt



- 昨年来のトランプ政策の影響等によるアカデミア分野での減収傾向も、インダストリーへのシフトが結実し増収傾向へ転じる
- 営業利益率も価格政策とミックス改善 により4.3pt の改善
- さらに、インダストリー向けに戦略製品を順次上市

半導体プロセス・コントロール機器

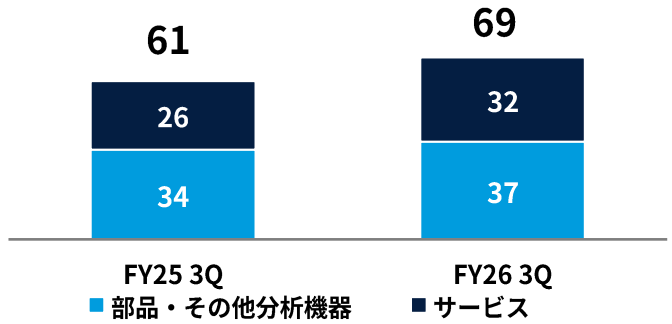
FY25 3Q	FY26 3Q	YoY
42	**55**	+29.4%
-0	**7**	-
-1.9%	**14.0%**	+15.9pt



- 受注はYoY 189%増と旺盛な需要が継続
- WFE、部品サービスで売上伸長
- アドバンスト・ロジック/ファウンドリ、メモリも引き続き順調
- 売上収益の増加に伴い営業利益も向上

部品・サービス

FY25 3Q	FY26 3Q	YoY
61	**69**	+12.4%
11	**1**	-91.2%
19.0%	**1.5%**	-17.5pt



- サービスは20%増収。海外でのインストールベース拡大、値上げ、拡販施策等効果で順調に推移
- 部品・その他分析機器は管球等の拡大で6.5%増収
- 営業利益率は特殊要因を除けば2.2ptの改善

注： 特殊要因として、米国にて貸倒引当金 6億円、欧州子会社（MILabs）の減損 7.5億円の損失を計上

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q累計 連結業績サマリー（YoY）

(億円)	FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	前年同期比
売上収益	594	**606**	+2.0%
売上総利益	324	**340**	+5.0%
営業利益(1)	65	**41**	-37.0%
営業利益率(%)	11.0%	**6.8%**	-4.2pt
税引前利益	60	**33**	-45.8%
四半期利益(2)	42	**24**	-42.0%
基本的EPS(円)	18.81	**10.95**	-
EBITDA	103	**91**	-11.5%
EBITDA率(%)	17.3%	**15.1%**	-2.3pt

- 受注はYoY 39%の増加
- 売上収益は多目的分析機器の減少を半導体プロセス・コントロール機器の増加でカバーし増収
- 売上総利益率は各カテゴリーで改善、連結ベースで YoY 1.6pt改善
- 売上総利益は増加に転じるも、計画通りの継続的な戦略投資による研究開発費、人件費増、および特殊要因により営業利益は前年同期を下回る

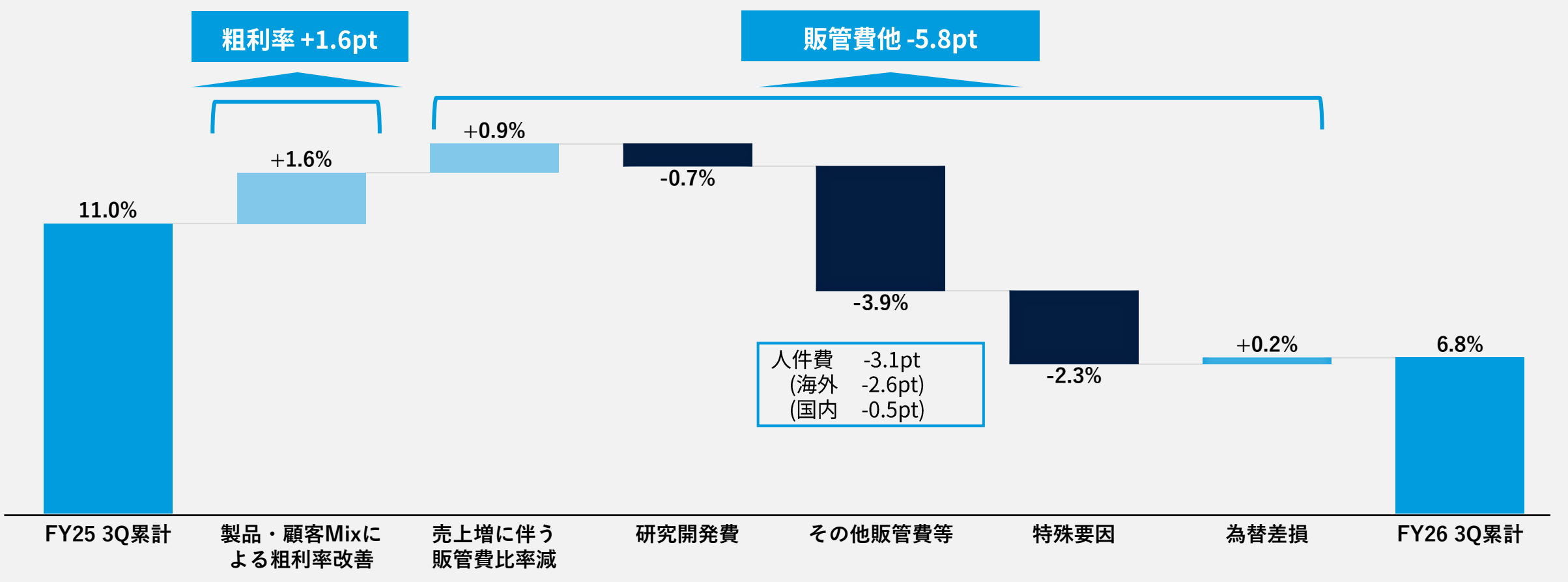
注:
1. 特殊要因として、米国にて貸倒引当金 6.5億円、欧州子会社（MILabs）の減損 7.5億円の損失を計上　2. 親会社の所有者に 帰属する四半期利益に読み替え

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q累計 連結営業利益要因分析（YoY）

■ **営業利益率　6.8%　　前年同期比 4.2pt減**

- 粗利率は、多目的分析機器をはじめとする各カテゴリーで向上
- 継続した戦略投資により研究開発費と販管費の割合が増加も、売上増で一部リカバリー



注：　特殊要因として、米国にて貸倒引当金6.5億円、欧州子会社（MILabs）の減損7.5億円の損失を計上

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

半導体プロセス・コントロール機器事業アップデート

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

次世代半導体向け戦略製品ロードマップ Update

市場と目標

- 2025年より次世代半導体向けに新製品群を上市。JEPによるPOR(1)化は順調に進捗、一部想定売上を前倒し達成見込み。
- 新製品市場参入成功により、顧客要望・市場環境が明確化。さらなる競争力強化を目指し、次々世代製品開発を加速。

	先端計測ニーズ	開発／上市ロードマップ 2025年	2026年	2027年	2028年	想定SAM (目標ｼｪｱ)@2030
ロジック	①GAA/CFET 3D構造形状計測 (GI-SAXS)	次世代ロジック XTRAIA CD-3200G (低エネルギーGI-SAXS) 開発中	★(2)			新市場 $100M(>50%)
ロジック・メモリ共通	②Si/SiGe超格子計測 (HR-XRD)	次世代ロジック・メモリ共通 XTRAIA XD-3300 ★		XTRAIA XD-3400 ★		$100M(>70%) 前倒し達成見込
	③HKMG超薄膜計測 (XRF/XRD複合機)	XTRAIA MF-3400(GEN4) ★		XTRAIA MF-3500(GEN5) TP/TTTM大幅強化 ★		$200M(>70%)
	④軽元素超薄膜計測 (XRF)	ONYX 3200 軽元素対応 ★		ONYX 3300 TP/TTTM大幅強化 ★		新市場 $100M(>50%) 前倒し達成見込
メモリ	⑤DRAM/NAND HAR(深孔)計測 (T-SAXS)	次世代メモリ XTRAIA CD-3200T ★		XTRAIA CD-3300T ★		$100M(>50%) 前倒し達成見込
	⑥3DDRAM欠陥計測 (XRT-Micron)	XTRAIA XT-3000 ★				$50M(>50%) 前倒し達成見込
アドバンスト・パッケージング	⑦先端PKGのバンプ/TSV欠陥検査 (X-ray Imaging)	AXI(Advanced X-ray Inspection) XHENA AX-3000	初号機出荷 ▲ ★	Portfolio拡大 ★		$300M(>30%)
Hybrid Metrology	⑧ロジック、メモリ立体構造形状計測	T-SAXSへOCD ベースソフト搭載 ★ 本格量産開始 ★	Hybrid Engine Step1 Validation	★ H.E. Step2 Co-optimization	★ H.E. Step3 Portfolio拡大	新市場 $100M(>50%)

主なアップデート

①27年に市場立ち上がりと想定。初号機出荷、Ontoソフト搭載しデファクト化へ

②過半顧客でPOR(1)化、28年に30年想定売上達成を視野。次々世代を睨みXD-3400開発。

③27年以降GEN3市場をGEN4で置換へ。2030年市場を睨みMF-3500(GEN5)開発。

④Aluminum超薄膜測定をUSP(3)として順調に市場浸透。27年に30年想定売上達成へ。

⑤メモリ量産ライン採用開始。28年に30年想定売上達成も視野。次世代3300T開発。

⑥Fab versionで3DDRAM市場拡大、27年に30年想定売上達成へ。

⑦リガク初のInspection機AX-3000、TSV中Void検査をUSP(3)として上市へ。

⑧CD-SAXS-OCDのHybrid EngineをOntoと共同開発。FY27.1Qメモリ量産ライン適用を目指し開発加速。

注：1. Process of Record（顧客量産プロセスで正式に採用された**標準装置**）2. ★：リガクにおける製品標準化・量産開始　3. Unique Selling Proposition

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 連結業績見通し

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 連結業績見通し – 据え置き

(億円)	FY25	FY26[1]	前期比
売上収益	941	**1,010**	+7.2%
営業利益	167	**194**	+16.1%
営業利益率(%)	17.7%	**19.3%**	+1.6pt
税引前利益	159	**184**	+15.2%
当期利益[3]	114	**125**	+9.6%
基本的EPS(円)	50.19	**55.27**	-
EBITDA	218	**253**	+15.9%
EBITDA率(%)	23.2%	**25.1%**	+1.9pt

3Q時点での変化点

- 多目的分析機器：受注好調も売上回復遅延継続
- 半導体プロセス・コントロール機器：モメンタムは2Q時点よりもさらに強い
- 部品・サービス：3Q時点でプラス転換、年間の売上収益は若干上振れ
- 粗利益率の改善が進む一方で特殊要因[2]が3Qに発生
- 年間受注高はYoY 約30%成長の見込み

現時点での年間見通し

- 売上収益：引き続きアップサイドを予想
- 営業利益：4Qは多目的分析機器での追い込みと研究開発費を除く経費抑制でガイダンス達成（特殊要因を除く）を目指す

注：
1. 対米ドル為替感応度：売上収益約2億円、営業利益約0.4億円、対ユーロ為替感応度：売上収益約0.7億円、営業利益約0.3億円
2. 米国にて貸倒引当金 6.5億円、欧州子会社（MILabs）の減損 7.5億円の損失を計上
3. 親会社の所有者に 帰属する当期利益に読み替え

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

2027年度の方向性

- 26年12月末受注残はYoY 30%超の増加を見込む、来期業績成長のVisibilityも向上
- 市場環境は各カテゴリーで上向き

	環境認識	戦略・展望
多目的分析機器	**■ インダストリーへのシフト進む** • インダストリー向け売上収益はFY26で60%超へ拡大 • FY26年間受注高はYoY 2ケタ増の見込み、来期成長に十分な手応え	**■ インダストリー向け成長加速を強力に推進** • インダストリー向け事業のもう一段の成長に向けて、半導体・電子部品分野、および自動化・自律化ニーズに開発・販売リソースを集中。高付加価値製品へのシフトによりマージンも拡大へ
半導体プロセス・コントロール機器	**■ AI半導体向け需要はアプリケーションに広がり** • 従来HBM中心だったAI半導体向け需要が、足元ではロジック、DRAM、フラッシュ、先端パッケージへと広がり、FY26年間受注高はYoY 70%増見込み	**■ 好調な受注を売り上げに転換、30%超成長へ** • 顧客新工場立ち上げと戦略製品の拡大で大きく成長 • 供給能力拡充に必要な各種施策に注力
部品・サービス	**■ 安定成長が期待できる事業環境へ** • サービスはインストールベース拡大で成長 • 特殊要因を除き部品・その他分析機器の収益安定化	**■ 懸念材料は払拭、成長路線回帰** • 安定した収益基盤のもと各事業で拡大図る • FY27に特殊要因は見込まず、EUVも来期中には顧客在庫払底へ

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

最後に

半導体プロセス・コントロール事業はフルスケールでの成長ステージへ

- 中長期でのAI半導体関連投資は継続、技術進化による事業機会は拡大、X線技術の採用加速
- リガクのロードマップでも複数製品で売上前倒し達成を見込み、FY26受注高は過去最高更新へ
- 300億円超の事業規模が年間30%成長の本格的な拡大局面入り

リガクの中長期成長の蓋然性向上

- 半導体プロセス・コントロール機器事業はFY26で営業利益の過半を占め、リガクの収益柱に成長
- 多目的分析機器事業での成長の道筋も明確になり、リガクの中長期業績の成長蓋然性高まる

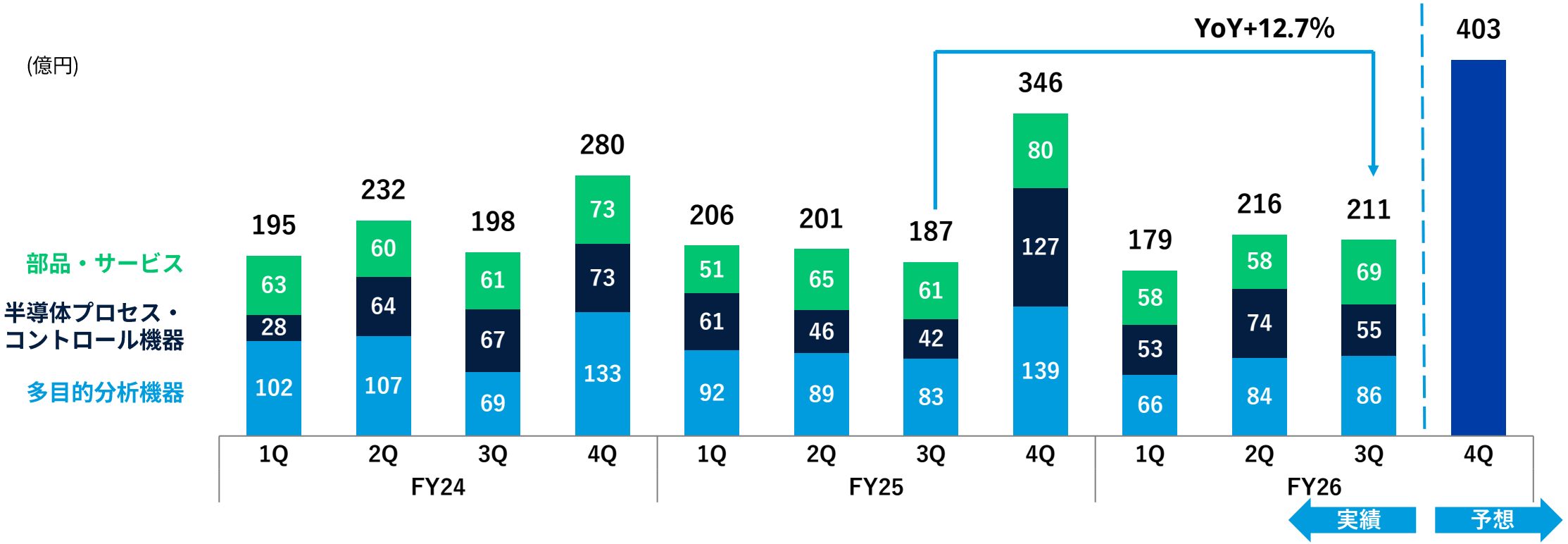
Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

Appendix

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

四半期毎売上収益の推移

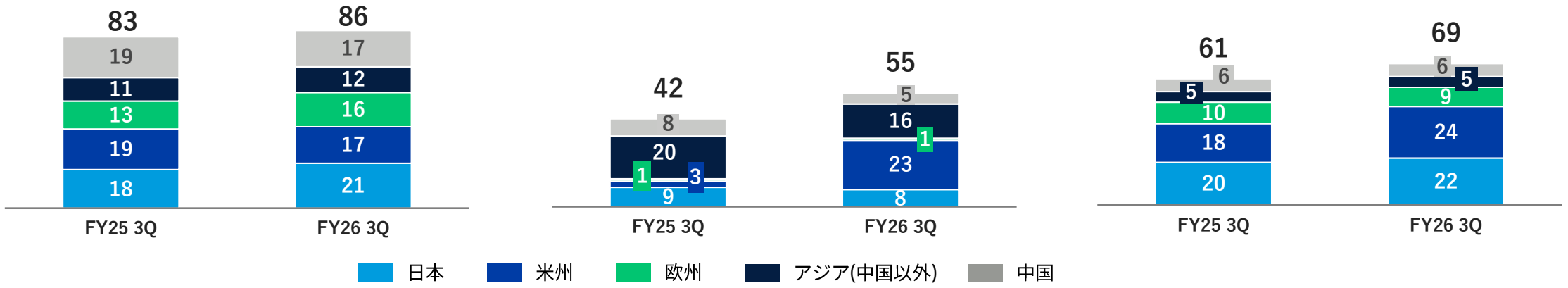
- 3Qは一部売上収益の期ずれでQoQ横ばいも、YoYで回復基調継続。多目的分析機器は堅調な受注を反映しYoY/QoQともに増収に転じる。半導体プロセス・コントロール機器の売上収益は、期初から4Qに案件集中でほぼ計画線で昨年比で上回る
- 足元では半導体プロセス・コントロール機器の旺盛な需要、多目的分析機器は引き続き受注の強さにより、4Qの収益拡大に向けて順調に進捗



Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q カテゴリー別業績サマリー（地域別売上収益）

（億円）	多目的分析機器 FY25 3Q	多目的分析機器 FY26 3Q	多目的分析機器 YoY	半導体プロセス・コントロール機器 FY25 3Q	半導体プロセス・コントロール機器 FY26 3Q	半導体プロセス・コントロール機器 YoY	部品・サービス FY25 3Q	部品・サービス FY26 3Q	部品・サービス YoY
売上収益	83	**86**	+4.4%	42	**55**	+29.4%	61	**69**	+12.4%
営業利益	4	**8**	+87.2%	-0	**7**	-	11	**1**	-91.2%
営業利益率 (%)	5.4%	**9.7%**	+4.3pt	-1.9%	**14.0%**	+15.9pt	19.0%	**1.5%**	-17.5pt



- 日本：インダストリーシフト先行順調
- 米州：QoQで減収幅縮小
- 中国：免税手続きが遅延したため4Qへ期ズレ
- 欧州：YoYでは回復

- 北米IDM及び半導体メーカーで伸長
- メモリ（DRAM）好調でアジアも高水準継続

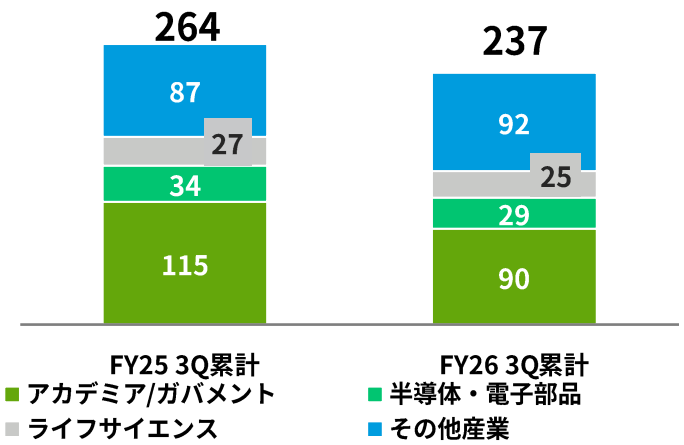
- X線管球の拡大及びサービスの堅調により米州、日本が増加

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q累計 カテゴリー別業績サマリー

多目的分析機器

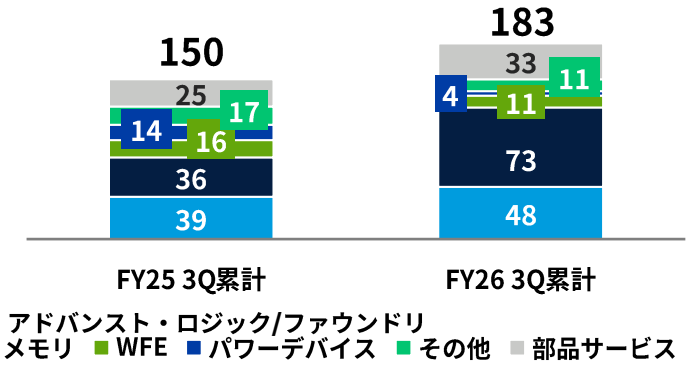
(億円)	FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	YoY
売上収益	264	**237**	-10.3%
営業利益	30	**8**	-71.1%
営業利益率 (%)	11.5%	**3.7%**	-7.8pt



- 昨年来のトランプ政策の影響等によるアカデミア分野での減収傾向は長期化。
- 粗利率は価格政策、ミックスの改善でYoY 1.8pt向上。

半導体プロセス・コントロール機器

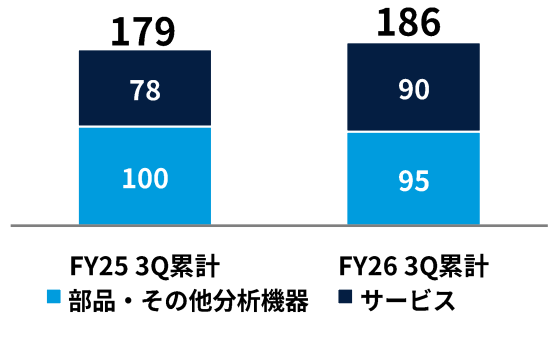
FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	YoY
150	**183**	+21.4%
23	**27**	+16.4%
15.7%	**15.1%**	-0.6pt



- 受注はYoY 117%増と旺盛な需要が継続
- アドバンスト・ロジック/ファウンドリ、メモリで売上大幅伸長
- 戦略投資継続で販管費が増加した結果、営業増益もマージンは若干低下。

部品・サービス

FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	YoY
179	**186**	+4.0%
32	**17**	-47.1%
18.3%	**9.3%**	-9.0pt



- サービスでは値上げ、拡販施策等の効果により15%増収
- 全体で売上収益、粗利率ともにYoY増加も、戦略投資継続および特殊要因等により営業利益悪化

注： 特殊要因として、米国にて貸倒引当金6.5億円、欧州子会社（MILabs）の減損7.5億円の損失を計上

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q累計 カテゴリー別業績サマリー（地域別売上収益）

多目的分析機器

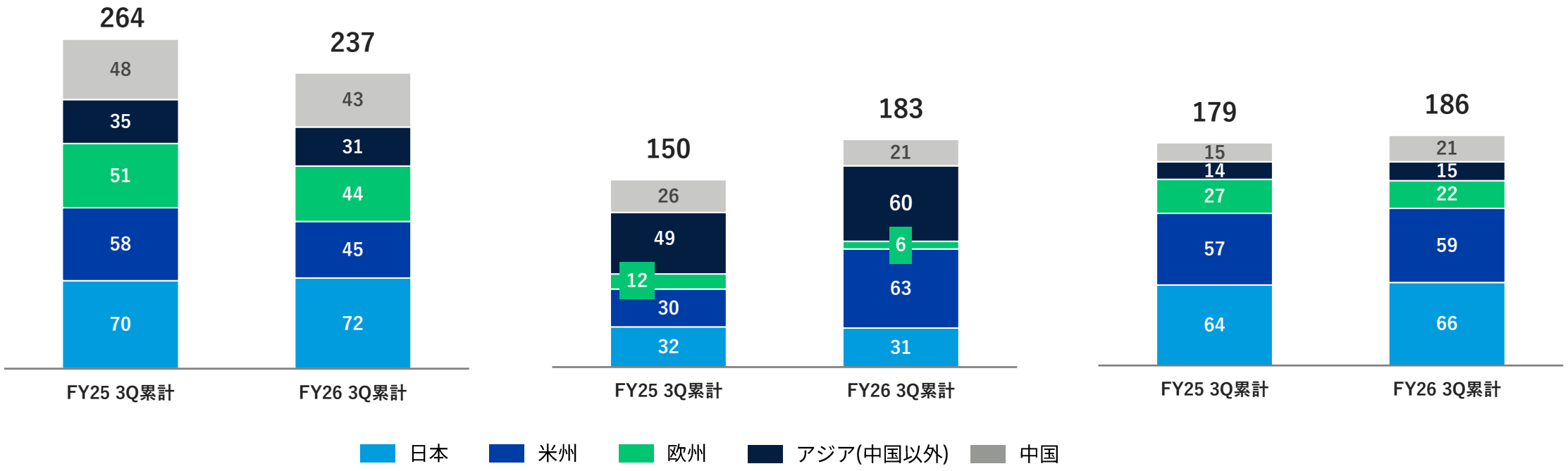
（億円）	FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	YoY
売上収益	264	**237**	-10.3%
営業利益	30	**8**	-71.1%
営業利益率 (%)	11.5%	**3.7%**	-7.8pt

半導体プロセス・コントロール機器

FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	YoY
150	**183**	+21.4%
23	**27**	+16.4%
15.7%	**15.1%**	-0.6pt

部品・サービス

FY25 3Q累計	FY26 3Q累計	YoY
179	**186**	+4.0%
32	**17**	-47.1%
18.3%	**9.3%**	-9.0pt

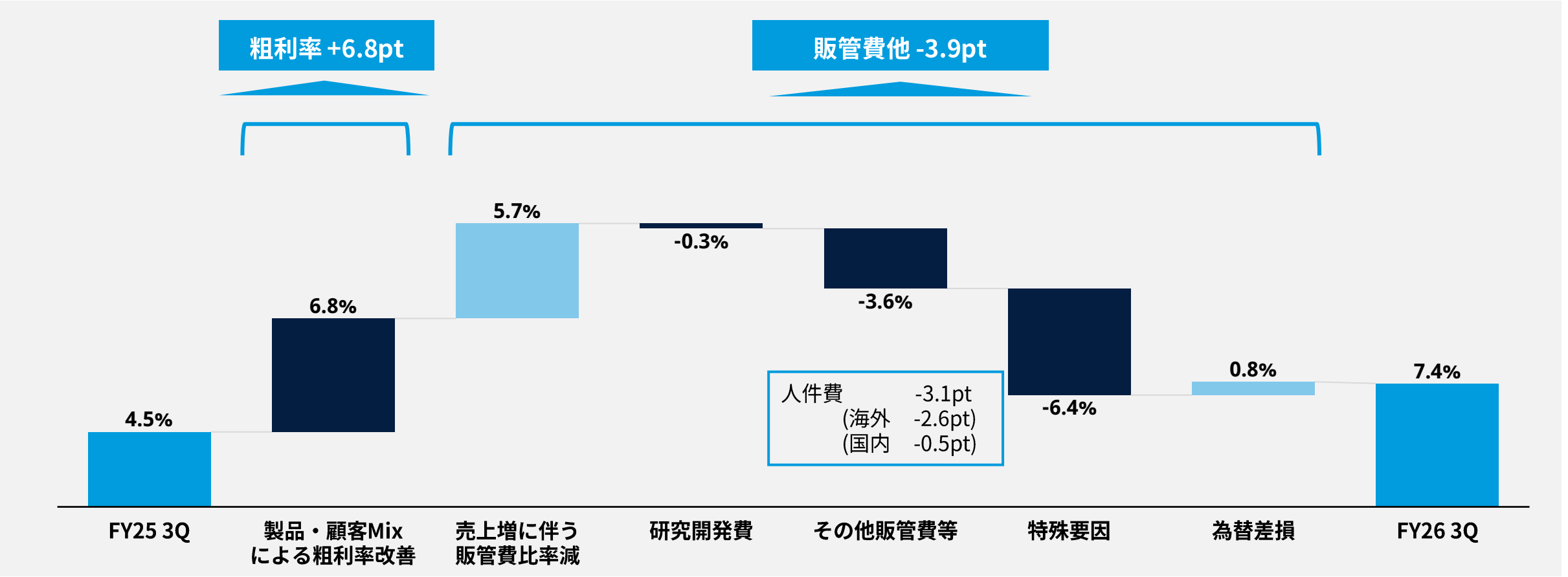


Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q 連結営業利益要因分析（YoY）

■ **営業利益率　7.4%　　前年同期比 +2.9pt**

- 粗利率は、主に半導体プロセス・コントロール機器における高利益率案件（米国）により改善
- 戦略投資としての研究開発費と販管費（主に半導体プロセス・コントロール機器事業強化の人件費と海外成長投資）の増加を売上増により吸収、営業利益率は2.9pt向上



注：　特殊要因として、米国にて貸倒引当金 6億円、欧州子会社（MILabs）の減損 7.5億円の損失を計上

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

製品別損益 (管理会計ベース) (1)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 1Q	FY25 2Q	FY25 3Q	FY25 4Q	FY25 Full-year	FY26 1Q	FY26 2Q	FY26 3Q	FY26 4Q
多目的分析機器/Multipurpose Analytical Instruments									
売上収益/Revenue	9.2	8.9	8.3	13.9	40.4	6.6	8.4	8.6	-
営業利益/Operating Profit	1.2	1.3	0.4	3.1	6.2	-0.2	0.3	0.8	-
営業利益率/Operating Margin	13.6%	15.0%	5.4%	22.7%	15.4%	-4.0%	3.6%	9.7%	-
半導体プロセス・コントロール機器/Semiconductor Process Control Instruments									
売上収益/Revenue	6.1	4.6	4.2	12.7	27.8	5.3	7.4	5.5	-
営業利益/Operating Profit	1.6	0.8	-0.0	5.6	8.0	0.5	1.4	0.7	-
営業利益率/Operating Margin	26.3%	17.9%	-1.9%	44.7%	29.0%	10.9%	18.9%	14.0%	-
部品・サービス/Components and Services									
売上収益/Revenue	5.1	6.5	6.1	8.0	25.9	5.8	5.8	6.9	-
営業利益/Operating Profit	0.5	1.5	1.1	1.8	5.1	1.0	0.6	0.1	-
営業利益率/Operating Margin	11.2%	23.3%	19.0%	23.2%	19.8%	17.4%	10.5%	1.5%	-
連結合計/Consolidated Total									
売上収益/Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	21.6	21.1	-
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	1.9	1.5	-
営業利益率/Operating Margin	13.8%	14.3%	4.5%	29.2%	17.7%	3.5%	9.0%	7.4%	-

注：
1. 本情報は、投資家の皆さまの理解のために参考情報として作成したものであり、本社費を加味していないため、連結営業利益は各カテゴリーの合計値と一致しません

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

地域別、エンドマーケット別売上収益

地域別売上収益

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
日本/Japan	7.7	4.1	4.8	10.7	27.4	6.9	4.8	5.2	-	-
米州/Americas	4.5	5.9	4.0	8.7	23.4	4.6	5.5	6.5	-	-
欧州/EMEA	2.7	3.8	2.6	4.6	13.8	1.7	2.8	2.7	-	-
アジア(中国以外)/Asia (ex. China)	3.1	3.0	3.7	6.9	16.8	2.0	5.2	3.4	-	-
中国/China	2.3	3.2	3.4	3.5	12.5	2.5	3.1	2.9	-	-
売上収益合計/Total Revenue	**20.6**	**20.1**	**18.7**	**34.6**	**94.1**	**17.9**	**21.6**	**21.1**	-	-

エンドマーケット別売上収益

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
半導体・電子部品/ Semiconductor/Electronic Components	7.7	6.1	4.9	14.3	33.3	6.0	8.7	6.9	-	-
ライフサイエンス/Life Science	0.9	0.8	1.3	1.9	5.0	0.8	0.9	1.1	-	-
その他産業/Other Industries	3.4	3.5	3.5	5.1	15.7	3.4	4.1	3.9	-	-
アカデミア&ガバメン ト/ Academia/Governments	4.6	5.9	5.1	9.1	24.8	3.1	3.6	4.5	-	-
サービス/Services	3.7	3.6	3.7	4.1	15.1	4.4	4.1	4.5	-	-
売上収益合計/Total Revenue	**20.6**	**20.1**	**18.7**	**34.6**	**94.1**	**17.9**	**21.6**	**21.1**	-	-

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

連結 四半期業績

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 1Q	FY25 2Q	FY25 3Q	FY25 4Q	FY25 Full-year	FY26 1Q	FY26 2Q	FY26 3Q	FY26 4Q	予想/FCT Full-year
売上収益/Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	21.6	21.1	-	**101.0**
売上総利益[(1)]/Gross Profit[(1)]	11.5	11.1	9.7	20.4	52.8	9.7	11.9	12.4	-	**58.9**
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	1.9	1.5	-	**19.4**
税引前利益/Profit Before Taxes	2.7	2.7	0.6	9.8	15.9	0.4	1.6	1.2	-	**18.4**
当期利益/Net Profit	1.9	1.8	0.4	7.1	11.4	0.3	1.2	0.8	-	**12.5**
基本的EPS（円）/Basic EPS (JPY)	8.52	8.23	2.18	31.38	50.19	1.46	5.74	3.76	-	**55.27**
Non-IFRS Indicator										
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	3.3	3.3	1.3	10.6	18.6	1.1	2.4	2.8	-	**21.5**
調整後当期利益/Adjusted Net Profit	2.2	2.1	0.8	7.4	12.7	0.6	1.6	1.9	-	**13.9**
調整後EPS（円）/Adjusted EPS (JPY)	-	-	-	-	55.19	-	-	-	-	**61.40**
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	3.3	3.7	-	**25.3**
調整後EBITDA/Adjusted EBITDA	4.0	4.0	2.1	11.4	21.7	2.0	3.3	3.7	-	**25.3**
対売上収益比率/Adjusted EBITDA Margin	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	11.3%	15.5%	17.8%	-	**25.1%**
ROE	-	-	-	-	13.4%	-	-	-	-	**13.5%**
調整後ROE/Adjusted ROE	-	-	-	-	14.9%	-	-	-	-	**15.0%**
研究開発費/R&D Expenses	1.6	1.8	1.8	1.9	7.3	1.7	2.0	1.9	-	**8.5**
設備投資額/CAPEX	0.6	3.4	1.0	1.5	6.6	1.0	1.9	0.7	-	**7.7**
減価償却費/Depreciation	1.2	1.2	1.3	1.3	5.1	1.4	1.4	1.4	-	**5.8**
JPY/USD	151.2	147.5	147.8	149.8	149.8	156.5	158.6	158.9	-	**145.0**
JPY/EURO	159.4	162.2	165.6	169.5	169.5	183.5	184.8	184.2	-	**165.0**

注：
FY25 Q1の売上総利益は、FY26の費用構造に合わせて一部費用の分類を変更したことに伴い、再表示しております。そのため、当初開示した数値とは異なります。なお、FY25 Q2以降については、FY26と同様の分類を適用しております。

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

FY26 3Q B/S & キャッシュ・フロー

B/S

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 Year-end	FY26 3Q	Changes
流動資産/Current Assets	76.2	77.7	1.4
現預金/Cash and Cash Equivalents	24.2	26.4	2.1
棚卸資産/Inventories	20.8	29.0	8.1
営業債権、その他流動資産など/ Trade Receivables, Other Current Assets, etc.	31.1	22.2	-8.9
非流動資産/Non-Current Assets	108.9	108.2	-0.6
有形固定資産/Property, Plant & Equipment	22.6	23.9	1.3
のれん、無形資産など/Goodwill, Intangible Assets, etc.	86.3	84.3	-1.9
資産合計/Total Assets	**185.2**	**186.0**	**0.8**

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 Year-end	FY26 3Q	Changes
負債/Liabilities	**96.8**	**99.1**	**2.3**
有利子負債/Interest-Bearing Debt	62.1	66.6	4.5
その他負債/Other Liabilities	34.6	32.4	-2.2
資本合計/Total Equity	**88.3**	**86.9**	**-1.4**
負債・資本合計/Total Liabilities and Equity	**185.2**	**186.0**	**0.8**

キャッシュ・フロー

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 3Q YTD	FY26 3Q YTD	Changes
営業キャッシュ・フロー/Operating Cash-Flow	5.2	6.0	0.7
投資キャッシュ・フロー/Investing Cash-Flow	-5.0	-3.8	1.2
フリーキャッシュ・フロー/Free Cash-Flow	0.2	2.2	2.0
財務キャッシュ・フロー/Financing Cash-Flow	-5.9	0.1	6.0
為替換算差異/Impact on Exchange Rate	-0.8	-0.1	0.7
ネットキャッシュ・フロー/Net Cash-Flow	-6.6	2.1	8.8

財務指標

	FY25 Year-end	FY26 3Q	Changes
ネットデット÷調整後EBITDA(1)/ Net Debt / Adjusted EBITDA (1)	1.7x	2.0x	-
自己資本比率/Equity Ratio	47.7%	46.7%	-

注：
1. FY26 3Qの値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

調整後利益等における調整項目(1/2)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26			
EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q
税引前利益/Profit Before Taxes	**2.7**	**2.7**	**0.6**	**9.8**	**15.9**	**0.4**	**1.6**	**1.2**	**-**
減価償却費及び償却費/Depreciation and Amortization	1.2	1.2	1.3	1.3	5.1	1.4	1.4	1.4	-
支払利息/Interest Expenses	0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	0.2	0.3	0.3	-
受取利息及び配当金/Interest and Dividend Income	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.4	-0.0	-0.0	-0.1	-
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.7	-
EBITDA	**4.0**	**4.1**	**2.1**	**11.5**	**21.8**	**2.0**	**3.3**	**3.7**	**-**
利益率/Margin	19.6%	20.4%	11.7%	33.2%	23.2%	11.3%	15.5%	17.8%	-

調整後EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q
EBITDA	**4.0**	**4.1**	**2.1**	**11.5**	**21.8**	**2.0**	**3.3**	**3.7**	**-**
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-
調整項目計/Total Adjustments	**-**	**-0.0**	**-**	**-0.0**	**-0.1**	**-**	-	-	-
調整後EBITDA/Adjusted EBITDA	**4.0**	**4.0**	**2.1**	**11.4**	**21.7**	**2.0**	**3.3**	**3.7**	**-**
利益率/Margin	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	11.3%	15.5%	17.8%	-

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

調整後利益等における調整項目(2/2)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26			
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q
営業利益/Operating Profit	**2.8**	**2.8**	**0.8**	**10.1**	**16.7**	**0.6**	**1.9**	**1.5**	-
PPA償却費/PPA Amortization	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	-
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.7	-
調整項目計/Total Adjustments	**0.5**	**0.4**	**0.5**	**0.4**	**1.9**	**0.5**	**0.5**	**1.2**	-
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	**3.3**	**3.3**	**1.3**	**10.6**	**18.6**	**1.1**	**2.4**	**2.8**	-
利益率/Margin	16.3%	16.5%	7.2%	30.6%	19.8%	6.4%	11.4%	13.4%	-

調整後当期利益/Adjusted Profit	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q
当期利益/Profit	**1.9**	**1.8**	**0.4**	**7.1**	**11.4**	**0.3**	**1.2**	**0.8**	-
PPA償却費/PPA Amortization	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	-
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.7	-
調整項目計/Total Adjustments	**0.5**	**0.4**	**0.5**	**0.4**	**1.9**	**0.5**	**0.5**	**1.2**	-
調整項目に対する税金等調整/Tax Adjustments to Total Adjusted Items	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.6	-0.1	-0.1	-0.1	-
調整後当期利益/Adjusted Profit	**2.2**	**2.1**	**0.8**	**7.4**	**12.7**	**0.6**	**1.6**	**1.9**	-
利益率/Margin	11.0%	10.7%	4.5%	21.5%	13.5%	3.8%	7.6%	9.3%	-

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

Rigaku at a Glance

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

Company Highlights

会社概要

- 75年のイノベーションの歴史を持つ、先端X線技術のグローバルリーダー
- 高度な研究開発力により、業界トップクラスの収益性を実現
- 半導体プロセス・コントロール分野の20%超の成長により高いEBITDAマージンと持続的な成長を実現

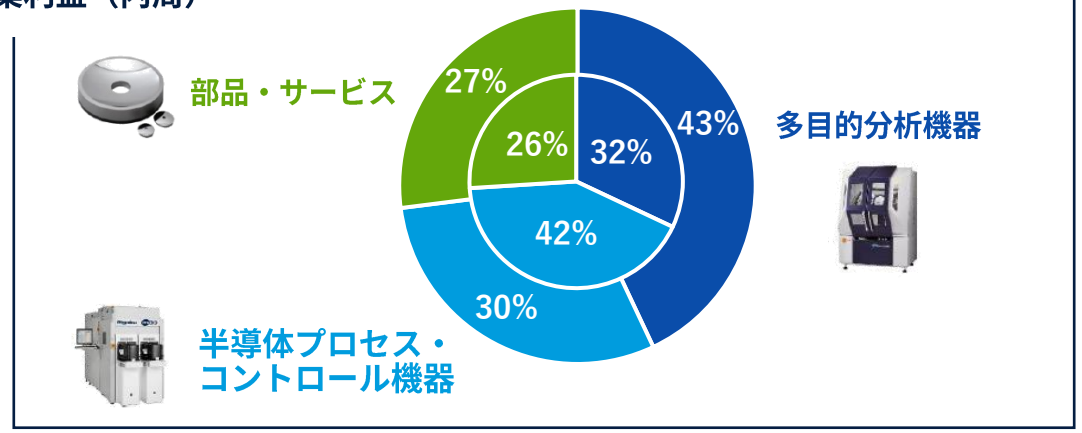
高い成長力と収益性を兼ね備えた財務プロファイル（2025年12月期）

売上収益 941億円	EBITDA(2) 218億円 （マージン 23.2%）
半導体プロセス・コントロール機器事業　売上収益 CAGR(1) 21%	海外売上収益比率(3) 71%
半導体前工程向けX線計測機器シェア(6) *グローバル No.1*	X線回折機器（XRD）シェア(4)(5) *グローバル No.2* *国内 No.1*

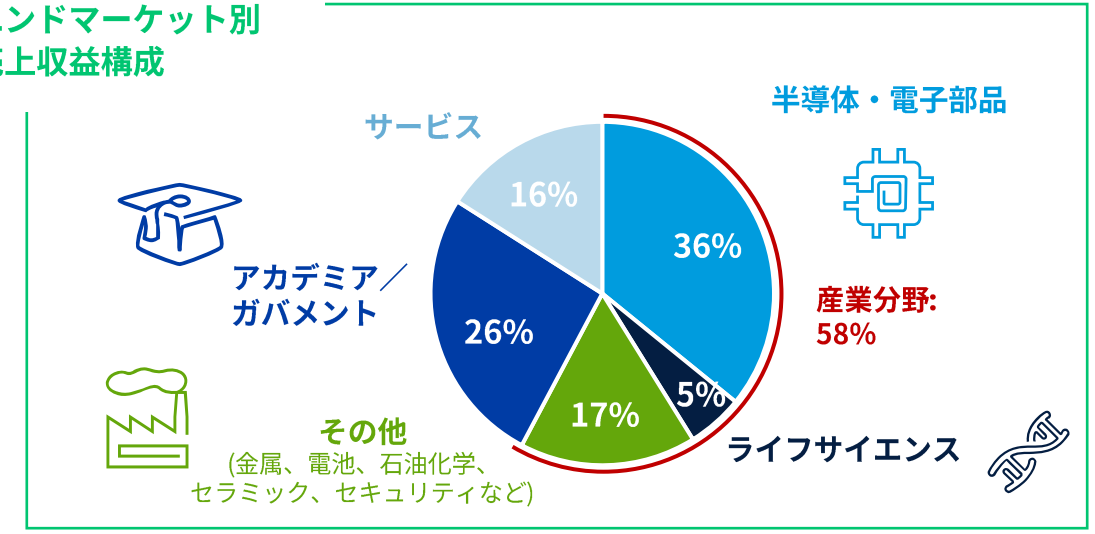
注：
1. 2022年12月期から2025年12月期までの3年間におけるCAGR
2. EBITDA=税金等調整前当期利益＋減価償却費及び償却費＋減損損失－受取利息及び配当金＋支払利息
3. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出
4. Strategic Directions International, Inc.「SDi Global Assessment Report 2025」
5. 株式会社アールアンドディ「科学機器年鑑 2025年版」
6. Yole Intelligence「2026 Yole Group Japan Visits - The Semiconductor Industry Trends」

多様なマーケットでの事業基盤（2025年12月期）

製品別売上収益（外周）営業利益（内周）



エンドマーケット別売上収益構成



Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

リガクの競争優位性

要素部品の開発・製造の内製化

X線発生装置

先進的なターゲット・ローテーション技術による高いX線輝度の実現



光学素子

X線／EUV向けの先端多層膜ミラー



最適なすり合わせによる、性能の最大化

解析ソフトウェア

AIによる解析で、Metrologyに役立つ複雑構造を可視化



X線検出器

高感度X線検出器に用いられる半導体を内製



内製化によるアドバンテージ

装置の高性能化

高速計測・高分解能・省エネルギー

開発サイクルの短縮

量産効果

技術資産

■ 熟練したX線技術者



研究開発者数(1)
約300

■ 特許網による参入障壁をグローバルで構築(2)



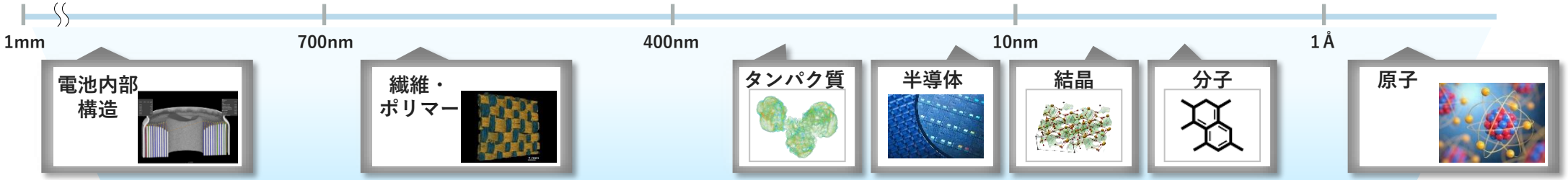
特許権	商標権	外国出願率
784件	350件	9割超
19カ国・地域	15カ国・地域	日本出願対比

注:
1. 基礎研究／製品開発へ従事する研究開発者数
2. 2026年７月現在

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

不可視の世界を可視化する：リガクのX線ソリューション

■ リガクはX線独自の計測ソリューションを確立し、微細領域の検査・計測需要の高まりを中心とした、多様な分析ニーズに対応



X線計測

微細ナノ計測： X線回折 / X線反射率 / X線小角散乱
サブナノスケール解像度

3D計測： X線イメージング / X線CT
X線の透過性による非破壊分析

物質の同定： 蛍光X線
蛍光X線による組成分析

X線回折


XRTmicron


MiniFlex


SmartLab

X線イメージング・X線CT


CT Lab HR160


CT Lab HV

蛍光X線


ZSX Primus IV


Qualana

蛍光X線・X線回折・X線反射率


WaferX 310

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

エンドマーケット別当社主要製品（多目的分析機器事業）

■ アカデミア・ガバメント

基礎研究・材料解析
✓ X線回折（XRD）


大学・研究開発機関



■ 半導体・電子部品

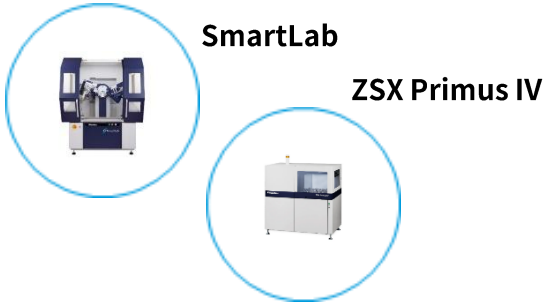
〈半導体〉
組成分析・信頼性評価
✓ 熱分析／蛍光X線（XRF）


半導体・薄膜




電池

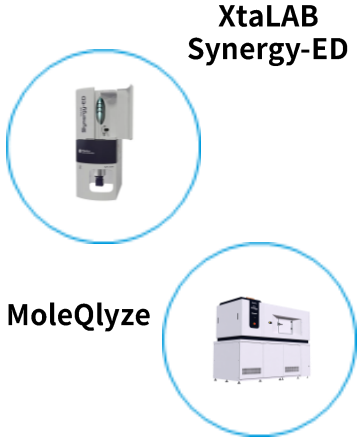
〈電池〉
結晶構造・ナノ構造解析
✓ X線回折（XRD）
✓ 蛍光X線（XRF）
✓ 小角X線散乱（SAXS）



■ ライフサイエンス

医薬品・生体構造解析
✓ X線回折（XRD）
✓ 電子密度トポグラフィー


医薬品



■ その他産業

原材料の組成・品質管理
✓ 蛍光X線（XRF）
✓ X線回折（XRD）


金属


石油・天然ガス


セラミックス



Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

半導体製造プロセスにおける主要製品（半導体プロセス・コントロール機器事業）

■ 半導体製造工程で求められる高度な検査・計測ソリューションを提供するリガクの製品は先端半導体の製造に不可欠

薄膜・レジストの膜厚測定


WaferX 310
膜厚・組成


XTRAIA MF-3400
膜厚・組成・密度・結晶性


XTRAIA XD-3300
結晶性・膜厚・密度


ONYX 3200
膜厚・組成

- 組成・結晶性測定を含む
- 薄膜化・多層化に伴うサブナノ測定ニーズが増大

表面金属汚染分析


TXRF310 Fab


TXRF-V310

- 前工程の各フェーズにおける表面汚染分析



New 新製品を開発中

多目的分析機器



膜厚、レジスト・ハードマスクの形状分析


XTRAIA CD-3010G
ナノ形状


XTRAIA CD-3200T
ナノ形状

- GAA構造にも対応する非破壊での内部構造評価、先端メモリ向けの非破壊での深穴形状測定ニーズ等を捕捉

先端パッケージングでのバンプ組成・形状測定

ONYX 3200
SnAgバンプ組成、形状

WaferX 310
バンプ電極膜厚、組成

- 汚染や異物、傷等の検査
- チップレット集積で増加する配線・電極・バンプの膜厚・組成
- TSV(2)欠陥検査
- CoWoS・HBM等先端ソリューションにも対応

注：
1. CoW = Chip on Wafer, WoW = Wafer on Wafer
2. TSV = Through-silicon Via

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

リガクの成長戦略コンセプト（3本の矢）

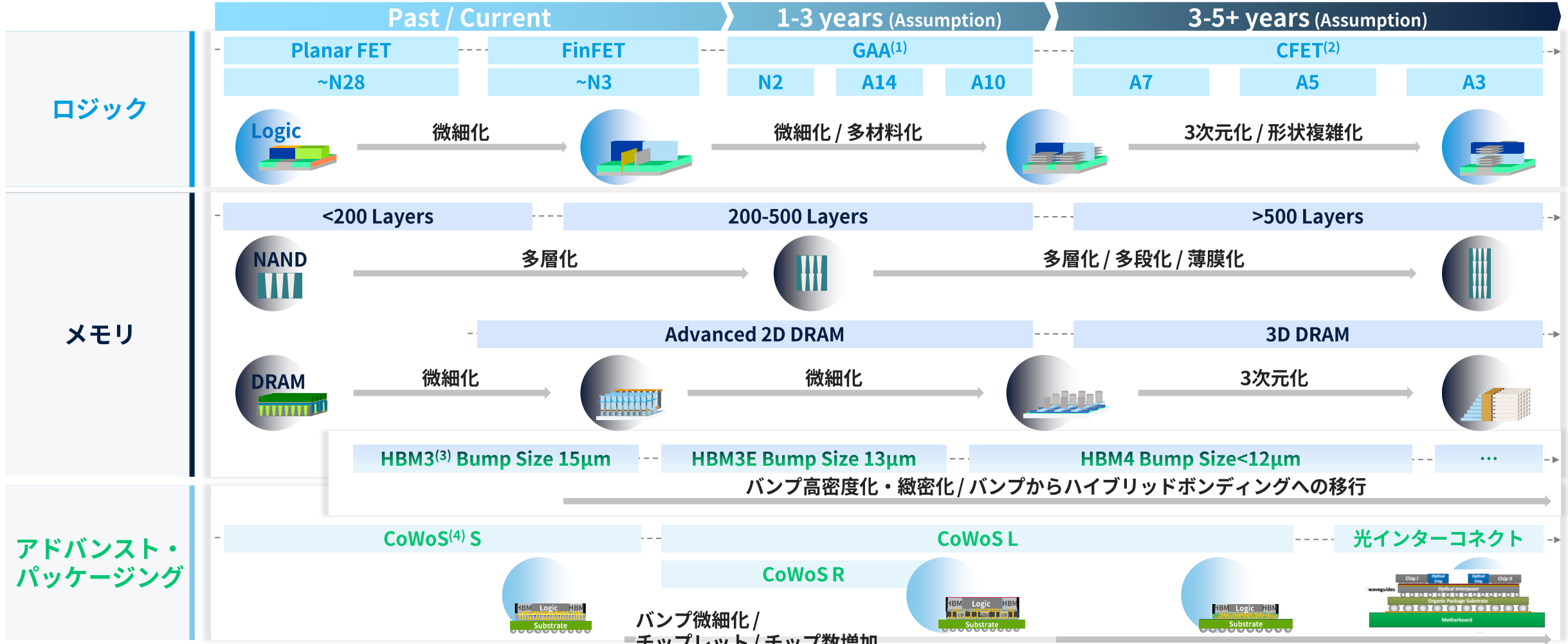
■ アプリケーション毎に最先端の計測需要に対応するソリューションを確立し、Lab to Fab戦略の推進により中長期成長を企図

	Pillar1 基盤戦略の強化	Pillar2 半導体でのLab to Fab戦略の推進	Pillar3 Lab to Fab戦略の拡大展開
	多目的分析機器	半導体プロセス・コントロール機器	多目的分析機器
	多目的分析機器における先端X線分析ソリューションへの需要の高まり	半導体産業の発展に必要不可欠なX線技術	新たなアプリケーションの開発による新市場の創出
基本戦略	▪ 卓越したX線要素技術力と強固な顧客基盤をレバレッジに、多様化・高度化する顧客のR&Dニーズに対応 ▪ 海外コマーシャル・インフラに積極投資を行い、グローバル市場でシェア拡大	▪ Lab to Fab戦略を強力に推進し、半導体X線計測市場におけるグローバルリーダー ▪ 半導体の微細化・積層化に対応する新しいソリューションの提供で事業領域を拡大	▪ イノベーションが活発な産業分野へのLab to Fab戦略の拡大・多目的分析機器のFab仕様化
注力分野	▪ グローバルサプライチェーンの強化 ▪ サービス事業の拡大	▪ 半導体先端技術トレンドに即したソリューション提供 ▪ 光学・CD計測との補完により事業領域を拡大（Hybrid Metrology） ▪ アドバンスド・パッケージング検査への参入	▪ パワーデバイス(次世代化合物半導体) ▪ 電池 (全・半固体電池等) ▪ ライフサイエンス(バイオ医薬品等)

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

先端半導体製造における検査・計測ニーズ

■ 半導体構造の微細化・多層化により高精度な計測・検査技術がより一層不可欠になったことで、半導体製造工程はターニングポイントに突入



注:
1. GAA = Gate All Around　2. CFET = Complementary FET　3. HBM3 = High Bandwidth Memory第3世代　4. CoWoS = Chip-on-Wafer-on-Substrate

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

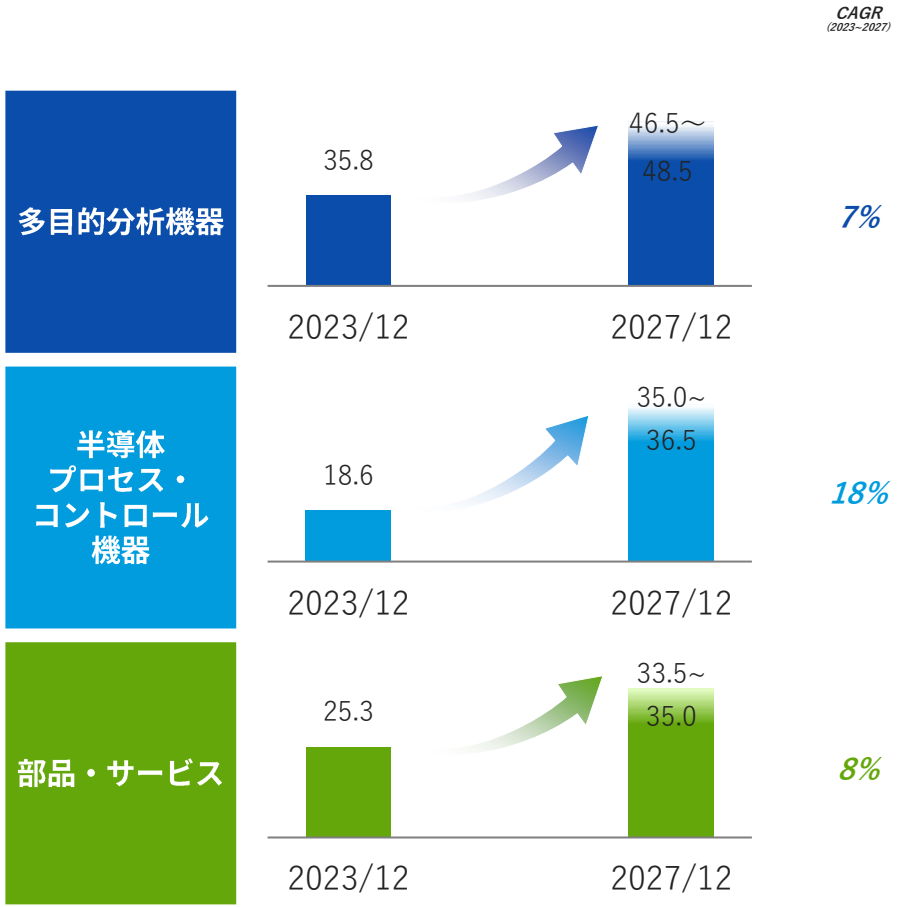
中期経営計画

■ 半導体プロセス・コントロール機器の力強い成長により、売上高年平均成長率（CAGR）約10%を目指す

中期計画目標値（全社）

	中計基準年度（2023年12月期）	2025年12月期（実績）	2026年12月期（予想）	中期計画目標（2027年12月期）
売上収益 YoY	798億円 27.4%	941億円 3.9%	1,010億円 7.2%	1,150~1,200億円(1) (CAGR約10%)
調整後EBITDA(2) Margin	202億円 25.3%	217億円 23.0%	253億円 25.1%	315~325億円 約27%
調整後営業利益(3) Margin	183億円 22.9%	186億円 19.8%	215億円 21.3%	265~275億円 約23%
株主還元	-	18.8円/株	19.0円/株	配当性向 約30%
研究開発費比率(4)	6.5%	7.8%	8.5%	約9%
設備投資額比率(5)	3.5%	7.1%	7.7%	約5%(6)
要員数(7)	1,994人	2,226人	2,351人	2,500~2,600人

製品カテゴリー別売上高成長目標（10億円）



注：
1. レンジ幅は売上収益の中期計画目標の5%の範囲内に設定（調整後EBITDA、調整後営業利益及び要員数のレンジ幅についてもそれぞれ同様）。売上収益の中期計画目標におけるYoY成長率は、2023年12月期を基準とする2027年12月期までの4ヶ年における売上収益の年平均成長率で、2025年12月期から2027年12月期までの各期の売上収益は想定為替レートを1ドル145円、1ユーロ156円として算出
2.調整後EBITDA＝税金等調整前当期利益＋減価償却費及び償却費＋減損損失－受取利息及び配当金＋支払利息＋一時費用
3.調整後営業利益＝営業利益＋PPA償却費＋減損損失＋一時費用
4. 研究開発費比率＝研究開発費/売上収益
5. 設備投資額比率＝設備投資額/売上収益　設備投資額は使用権資産を除いた設備投資の金額により算出
6. 2027年12月期の設備投資額比率目標は、その分子となる設備投資額に現在時点で計画されていない山梨工場に続く大型の工場改修・増強投資を含まない
7. 要員数は年度末の就業人数と年度平均の臨時雇用人数の合計により表示

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

用語集

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

用語集(1/3)

用語	説明
AXI	• Advanced X-Ray Inspectionの略称。X線を用いた自動検査装置。電子基板や半導体内部の欠陥を非破壊で検出し、品質管理を効率化する
CFET	• Complementary FET(CFET)は、N型FETとP型FETを垂直方向に積層して統合する次世代の半導体デバイス技術 現在主流のFinFETやGAA(Gate-All-Around)FETに続く技術として期待されている
CoWoS	• Chip on Wafer on Substrateの略称。TSMCが開発した先進パッケージ技術の一つ。 複数のチップをシリコンインターポーザー上に実装し、基板に搭載することで、高速・大容量のデータ処理と省スペース化を実現
DicifferX WAXS Edition	• 高分子フィルム、繊維、薄膜などの材料における原子・分子構造、結晶相および分子配向を高精度かつ数秒以内に測定する先進的なX線分析装置
Electron Density Topography **（電子密度トポグラフィー）**	• 結晶内部の電子の分布(電子密度)を可視化する技術。これにより、材料の原子構造や結合の状態を詳細に調べることが可能
EUV	• Extreme Ultravioletの略称。波長が約13.5nmの紫外線を指し、半導体製造の露光プロセスで使用される光源技術
GAA	• Gate-All-Aroundの略称。 トランジスタ技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャネルに接触、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す
GaN	• ガリウム(Ga)と窒素(N)で構成される化合物半導体材料

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

用語集(2/3)

用語	説明
JEP	• Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。確認できれば当装置の購入に繋がり、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる
Qualana	• 高い分析精度を備え、位置ずれのない微小領域および広域マッピングを高精度に実現する先進的なＸ線分析装置。 軽元素までも高感度で検出し、リガク独自のFPプログラムにより、柔軟な薄膜定量分析をサポート
SiC	• シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料
SiGe	• シリコン(Si)とゲルマニウム(Ge)で構成される合金半導体材料
TFXRD	• 半導体産業における薄膜特性の高精度な評価を目的としたX線回折(XRD)装置。 特に、200mmおよび300mmの大口径ウェーハ上の薄膜の測定に対応しており、研究開発から製造プロセスのモニタリングまで 幅広く利用されている
T-SAXS	• Transmission Small-Angle X-ray Scatteringの略称。透過型小角X線散乱法。 物質にX線を透過させ、その散らばり方を分析することで、物質内部のナノメートルスケールの微細構造を非破壊で解析できる手法。 半導体部品内部の微細な状態を詳しく確認する際に用いられる
WFE	• Wafer Fab Equipment の略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す
X線CT	• X線コンピュータ断層撮影（CT）は、対象物の密度分布を3Dで非破壊的にスキャンし、内部構造を明らかにするX線イメージング技術

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries

用語集(3/3)

用語	説明
XRD (回折)	• X線回折(XRD)。結晶試料にX線を照射するときに生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法
XRF (蛍光)	• X-Ray Fluorescenceの略称。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法
XRTmicron	• 高輝度X線光源と専用光学系を用いた高分解能・高速X線トポグラフィ装置。 Si、SiC、GaNなどの単結晶材料に対応。結晶欠陥を非破壊、全自動で検出できることから、半導体生産の歩留まり向上に寄与できる
XtaLAB Synergy ED	• リガクの単結晶X線構造解析の要素技術と日本電子の透過型電子顕微鏡の要素技術を組み合わせて作られた電子線回折装置。 従来よりも微細な粉末状の結晶でも測定が可能。これまで解析が困難であった物質でも構造情報を得ることができる
ZSX Primus III NEXT	• 上面照射型の走査型X線分析装置。生産管理で広く使われてきた汎用モデル「ZSX PrimusIII+」の後継機
ZSX Primus IV	• 4kWの強力なX線を用いて、物質に含まれる元素を詳しく調べる波長分散型のX線分析装置

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries



免責事項

本プレゼンテーションに含まれる将来見通し、計画、戦略などは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。
実際の業績は、経済情勢や市場動向などの要因により、これらの見通しとは大きく異なる可能性があります。
本資料は、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
本プレゼンテーションの内容は予告なく変更または削除される場合があります。
また、本資料の利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

Copyright 2026 Rigaku Holdings Corporation & its Global Subsidiaries